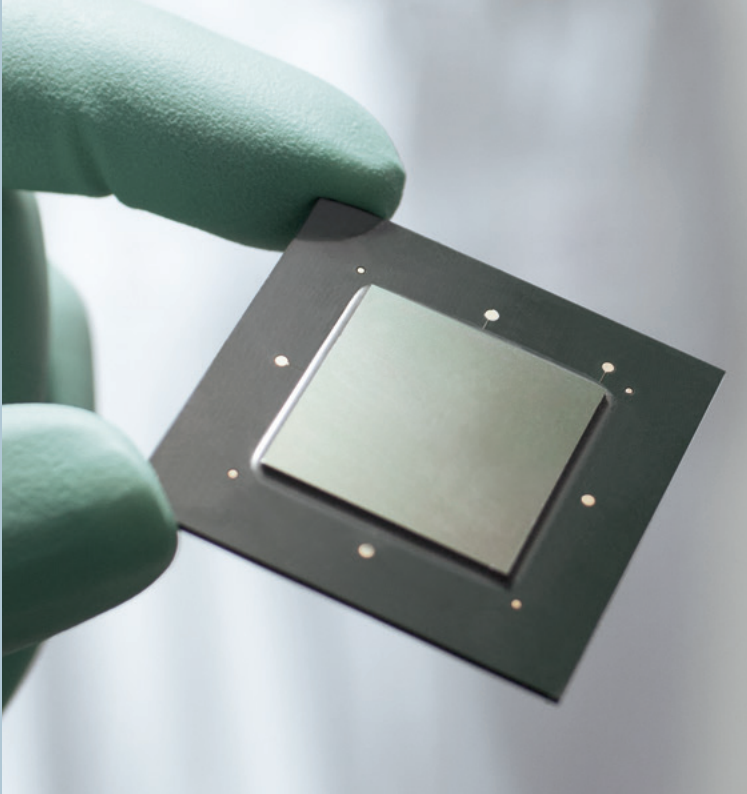


導電性ダイアタッチペースト

CONDUCTIVE DIE ATTACH PASTE



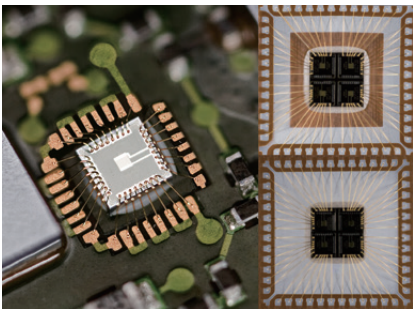
LOCTITE ABLESTIK (ロックタイト エイブルスティック) ABP 8068 シリーズは、高熱伝導性と高電気伝導性を有するプレッシャーレスシンタリングダイアタッチペーストです。この製品はエポキシ樹脂も含み、ハイエンドパワーパッケージの放熱・信頼性性能に不可欠な高接着、高熱伝導、優れたストレス特性を提供するように設計されています。

主な特長

- Ag + 樹脂によるハイブリッドシンタリングペースト
- < 3 × 3mm チップに適用可能
- 低温焼結 (175℃ ~ 200℃)、銀、金、PPF のリードフレーム上で優れた導電性と熱伝導性
- 従来のダイアタッチペーストと同等のディスペンス性

代表アプリケーション

- パワーデバイス
- 車載 IC (SOP、QFN、DFN など)



▶ 従来の導電性ダイアタッチペースト

Die

従来の高熱伝導型ダイアタッチペーストでは銀フィラーが界面にうまく接触しないため、高熱伝導を実現できません

▶ プレッシャーアシストシンタリングペースト

Die

空隙

通常の焼結材料は多孔質であるため、吸湿性が高く 吸湿性が高まり、熱サイクル性能に影響を与えます

▶ プレッシャーレスシンタリングペースト

Die

熱硬化樹脂

LOCTITE ABLESTIK ABP 8068T シリーズは、焼結銀と硬化樹脂の相互浸透ネットワーク (IPN) 構造により、ボイドフリーボンドラインを実現します

製品名	ABP 8068TA	ABP 8068TB	ABP 8068TI	ABP 8068TD	ABP 6395T
チップサイズ (mm)	< 3×3 (BSM付チップ用)	< 3×3 (BSM付チップ用)	< 3×3 (BSM付チップ用)	< 3×3 (BSM有無両方対応)	< 3×3 (BSM有無両方対応)
リードフレーム表面	Ag, PPF, Au	Ag, PPF, Au	Ag, PPF, Au	Cu, Ag, PPF, Au	Cu, Ag, PPF, Au
MSL (リフロー信頼性)	L1 260℃対応	L1 260℃対応	L1 260℃対応	L1 260℃対応	L1 260℃対応
体積抵抗 (Ohm/cm)	9.0 × 10 ⁻⁶	7.0 × 10 ⁻⁶	9.0 × 10 ⁻⁶	1.0 × 10 ⁻⁵	4.0 × 10 ⁻⁵
熱伝導率 (W/m-k)	110	100	165	50	30
推奨硬化条件	20分昇温後130℃×30分+ 15分昇温後200℃×1時間	20分昇温後130℃×30分+ 15分昇温後200℃×1-2時間	20分昇温後130℃×30-60分 +15分昇温後200℃×1時間	20分昇温後130℃×30分 +15分昇温後200℃×1時間	30分昇温後200℃×30分

*ここに記載されているテクニカルデータは代表値かつ参考値であり、規格値ではありません。